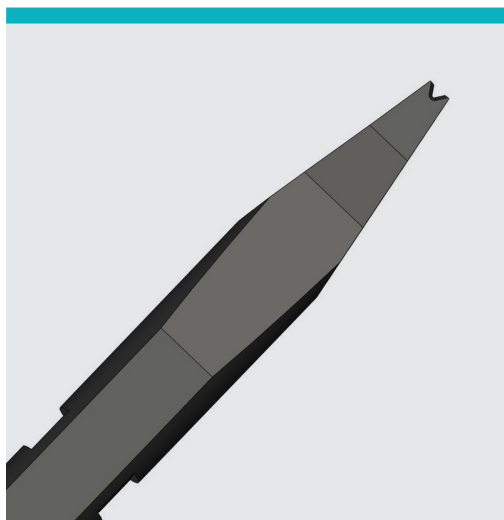




MP Micro Point Pro ■

MICRO POINT PRO WEDGE TOOLS

Tradizionalmente il wedge bonding è utilizzato per le applicazioni di bonding con filo di alluminio ma sta diventando una scelta anche per metodi di interconnessione come Tab, Flip Chip e altri.

MPP sviluppa e produce una vasta gamma di strumenti per il wedge bonding con vari metalli. Gli utensili più popolari, in carburo di tungsteno sono utilizzati per le applicazioni con filo di alluminio, mentre gli utensili in carburo di titanio sono adatti per il bonding di fili d'oro.

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89
info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.